

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

博敏电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 周艺轩
时间	2023年10月29日，16:00-17:00
地点	博敏电子股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监刘远程先生、董事会秘书黄晓丹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一个环节 公司相关介绍</p> <p>董事会秘书黄晓丹女士从行业情况切入公司情况，对三季报的相关数据进行了解读，还对公司当前创新业务中 AMB 陶瓷衬板的业务进展情况进行了介绍。</p> <p>第二个环节 交流环节</p> <p>Q1:第三季度毛利率大幅下滑原因是什么？分业务来看，收入和毛利率的情况是怎样的？</p> <p>A1: 公司第三季度毛利率下滑主要受到两方面影响：一方面，行业景气度下行叠加前期友商扩产产能陆续释放，市场需求不足，竞争内卷导致产品单价下降较多。另一方面，公司成本端压力增加，包括四费及新项目产能爬坡产生的固定成本增加较多，公司新建工厂从建设完工到完全达产需要经过一定的爬坡周期，在产能爬坡过程中，人员的工资支出、前期投入形成的资产</p>

和费用需要进行折旧、摊销。应该每个扩产的企业都会经历投产初期的压力，如果能扛住压力并尽快实现突破的话，我想未来企业的经营韧性会得到更好的体现。目前公司两大事业部的业务占比为 7:3。从发展趋势来看，现阶段创新业务及 PCBA、元器件业务扩展速度会更快，主要是陶瓷衬板、军品元器件、新能源模块等，上述高附加值产品的毛利率也更可观。未来伴随着江苏博敏二期扩产、梅州募投项目及合肥项目的顺利落地，将有效带动产能的提升，届时主营 PCB 业务的发展会更快。

Q2:三季度收入主要来自哪些领域？

A2: 主要来自新能源（含汽车电子）、数通、智能终端等领域。

Q3:从年初至今，整体产能利用率的变化情况如何？消费电子有无回暖的迹象？

A3: 随着行情的小幅回暖，产能利用率较年初有所恢复，目前综合产能利用率为 80%~90%。随着 8 月底以来华为等几款新机型的上市，消费电子有望打破此前的沉寂，梅州工厂有一条 R&F 专线，月产能 2 万平，其中 80%的产能对接歌尔、易力声及其他智能穿戴产品的 ODM/CM/EMS 类客户，目前这块订单量也在小幅回升。

Q4:产品价格下降的趋势是否会在 Q4 企稳？未来毛利率修复情况？

A4: 根据过往经验，本轮降价后价格接近企稳，了解到我们上游企业的情况，覆铜板厂商等通过前期的去产能出清，价格目前稳中有升。我们也会根据上游情况逐渐向下游传导，预计需要半年左右的时间，同时内部会紧跟行业发展趋势，持续做好产品结构的调整及精细化的成本管控等工作，毛利率有望在明年开始回升。

Q5:目前 AMB 业务实际的产能利用率是多少？主要用在什么领域里面？

A5: 公司 AMB 陶瓷衬板一期具备产能 8 万张/月，正在配合客户扩产到 12 万张/月，部分核心工艺环节具备 15 万张/月产能。目前 AMB 陶瓷衬板供应链下游主要包括军工、轨交、光伏、储能和新能源汽车等，我们客户结构主要在军工和车载两大类，其中军工占比 20-30%，车载占比 70-80%，现阶段公司 AMB 整体的产能利用率约 40%，一方面因为国内 SiC 材料扩产还需要一定时间，另一方面车企的认证周期均较长，且主要用于 800V 以上高档新能源车型，因此产能的提升主要取决于客户引入、认证和其扩产进程。

Q6:AMB 产能利用率目前的瓶颈在于订单还是工艺问题？

A6: 目前主要是市场需求不足和认证周期较长，客户也需要根据自身年度计划和市场需求进行分批下单。AMB 最初是 2016 年从军工切入，2018 年在深圳博敏孵化的项目，其率先在航天航空可靠性运用，降维到车规级、工业级、轨交级，产品先后在航空体系、轨交体系、电网体系等客户中开展样板验证和量产使用，其中车规级客户从 2020 年开始认证，2022 年已在多家功率半导体企业成功认证，今年在持续拓展新客户包括第三代半导体头部企业、海外车企供应链客户等，目前招投标进展良好，已通过了多家客户的认证且获得订单。公司 AMB 工艺领先，技术储备充分，在空洞率、冷热冲击可靠性测试、覆铜厚度、自研焊料配方等方面优势明显，目前深圳的产能足以承接当前客户需求，更多的产能需求我们会放在合肥项目去实现扩产。

Q7:AMB 目前的毛利水平如何？

A7: 当前 AMB 陶瓷衬板主要依赖于进口，国内整体市场竞争格局相对较好，具备量产的企业不多，前端工序与 PCB 共用，整体毛利率目前维持在较好水平，尤其是军品。

Q8:从公司 AMB 的应用场景来看, IGBT 和碳化硅占比如何?

A8: 公司 AMB 陶瓷衬板主要用于 SiC 器件, 因为 AMB-SiN 陶瓷基板是匹配 SiC 器件衬底的首选材料。AMB 氮化硅基板主要用于电动汽车 (EV) 和混合动力车 (HV) 功率半导体, AMB 氮化铝基板主要用于高铁、高压变换器、直流送电等高压、高电流功率半导体。

Q9:关于 IC 载板的进展, 产能情况, 客户拓展以及未来展望?

A9: 公司 IC 封装载板产品线是在江苏博敏二期新设的一条试产线, 伴随着新工厂的投产及产能爬坡, 今年在原有 tenting 工艺封装载板产品线基础上, 投资新增的首条高端细线路 mSAP 工艺封装载板和无芯板工艺进入运营阶段, 标志着公司正式具备涉足中高端 IC 封装载板领域的的能力, 并实现向 FC 类载板的技术转型。公司 IC 封装载板试产线达产后产能约 1 万平米/月, 产品主要应用于数据存储、微机电控制、光电显示和无线射频等领域, 其中 EMMC、MEMS、DRAM、Module 等存储类产品已配合多家封测类客户进入小批量生产阶段, SD/microSD 等产品送样认证中。但今年同样受行业需求影响, 一定程度上拉低了盈利能力。当今国内载板份额仅占全球载板份额的 5%左右, 国内能做的内资企业仅 2 家, 而国产芯片全球占比 20-30%, 在国产替代的大背景下, 替代空间巨大。同时政府也在积极推进芯片产业发展, 引进其他新型的芯片企业落地, 芯片企业扩产确定性比较高, 长期来看卡脖子的问题有望得到解决, 我们自身也在积极储备该领域的客户资源, 为国产替代贡献博敏力量。

Q10: 对于明年的收入预期, 预计达到什么水平?

A10: 如果四季度开始市场需求恢复较好, 外部环境没有较大冲击, 募投项目等顺利投产, 预计能回到既定的增速水平。公司未来会坚持既定战略, 不断修炼内功, 提升经营能力, 把控经营发展中的各项风险, 加强精益生产的管控, 进而提升盈利能力。

	<p>Q11: 关于未来两三年的发展预期和产品占比情况?</p> <p>A11: 公司坚持实施“PCB+元器件+解决方案”上下游一体化发展战略, 将 PCB 业务内核不断向外延拓展 (PCB+), 战略性聚焦“电源/储能、数据通信、汽车电子、智能终端”四大领域, 以“陶瓷基板、特色产品、数连产品”树差异, 将 PCB 业务内核持续向高质量、高价值领域延伸, 打造持续增长三级火箭, 实现产品结构升级及优质客户渗透。公司目前下游的分类占比按照四大行业划分, 三小业务目前占比不大, 但基于对行业发展的预判, 我们接下来还是会将部分传统 PCB 产能让给新的增量市场, 如陶瓷衬板、IC 载板、数连产品等发展前景更好的产品。</p>
日期	2023 年 10 月 30 日
备注	无